**晶方科技青年英才2022校园招募**

寻找会发光的你

企业介绍

苏州晶方半导体科技股份有限公司（SSE:603005），成立于2005年6月，是全球最大的新型传感器先进封装技术的开发商和提供商，坐落在长三角核心区域，中新合作苏州工业园区，并在以色列、美国硅谷、荷兰建立研发中心与生产基地。

公司创业16年，建立了一支对行业的技术市场具有前瞻性和洞察力的国际化研发和生产经营管理团队，拥有全球最完整的8英寸和12英寸晶圆级芯片尺寸封装量产线；独立承担并完成包括国家重大科技攻关项目02专项在内的国家级和省级科技攻关项目20多项；全面布局全球知识产权体系，全球专利数量超过300个。

累计封装100多亿颗各类传感器芯片，涵盖影像传感芯片、生物识别芯片、微机电系统芯片、医疗电子芯片等，广泛应用于手机、电脑、生物识别、安防、医疗电子、汽车电子等领域。在手机摄像头市场占有率超20%，在安防监控市场已经达到全球近90%的占有率。

岗位方向

研发类：产品工程师、工艺制程工程师、研发工程师、设计工程师等

技术类：设备工程师、厂务工程师等

综合职能类：计划工程师、采购工程师、运维工程师、质量工程师等

招聘要求

1、普通高校统招大学本科及以上学历毕业生

2、经教育部学历认证的海外留学毕业归国人员

3、理工科专业，物理、化学、材料、微电子、电子工程、光学等专业优先

福利薪酬

薪资：本科生9万元---12万元/年 研究生12万元---15万元/年

五险一金+商业保险，优秀员工股权激励，公司提供食宿及班车

投递渠道

扫码投递：



网申链接：

<http://xyz.51job.com/External/Apply.aspx?CtmID=5849009>

联系方式

招聘联系人:徐女士

招聘固话:0512-67730001-396

招聘邮箱:shuangshuang.xu@wlcsp.com